

社名	T O W A 株式会社							
事業内容	半導体モールディング装置・超精密金型の開発、設計、製造、販売 T O W A 株式会社は、半導体製造工程“モールディング”において、世界トップシェアを誇るメーカーです。 当社のモールディング技術は、最先端から汎用半導体デバイスまで幅広く採用されており、スマホ、自動車、LED照明等で人々の便利で快適な暮らしを陰で支えています。また、超精密加工技術で新たな分野へ展開する新事業にも取り組んでいます。							
資本金	89億3,262万円				従業員数	528名（2020年3月時点）		
本社所在地	京都市南区上鳥羽上調子町5番地							
勤務地	京都府（京都市、宇治田原町、宇治市）、佐賀県（鳥栖市）、海外各拠点							
募集職種	1. 理工系　開発設計(機械、電気、制御)、生産技術、製造、研究、技術営業、社内SE 等 2. 文科系　営業、生産管理、資材調達、総務、人事、経理、経営企画 等							
採用対象 （選択式）	理工学部	理工学部院生	文系学部	文系院生	短大生			
	機械系	情報系	電子系	物質系	数理系			
	留学生	U・Iターン歓迎						